证券代码：688362 证券简称：甬矽电子

**甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东北证券、敦和资管 |
| 时间 | 2024年9月11日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书李大林先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1.公司目前的产品结构有变化吗？**  公司产品结构相对稳定，从上半年数据看，FC类产品、晶圆级封装占比有所增加，QFN、SiP等成熟封装产品继续扩产，营收规模也在增长。长期来看，FC、晶圆级封装等先进封装产品的营收规模占比将进一步提升。  **2.公司对行业拐点有什么看法？**  公司认为集成电路行业整体成回暖趋势。同时，由于不同封测厂商的客户群和细分领域存在一定差异，节奏并不完全相同。得益于优良的客户群体，公司对持续保持较高的成长性相对乐观。  公司内部将自身发展划分为多个阶段，2018~2021年，公司营收从3000多万到达20多亿。22和23年受制于产能不足、二期筹建等因素，公司增长不显著。但23年下半年，二期正式启用，进入甬矽2.0阶段，中国台湾地区头部客户拓展顺利，新产品线顺利推进，量产稳定性也逐步得到验证，从去年Q4开始，公司连续三个季度都维持高速增长。  对于公司而言，随着客户的营收保持增长，公司会与客户一同成长，再加上新客户的拓展，公司对未来的增长情况相对乐观。  **3.公司下游景气度情况？**  公司营收主要来自消费电子、工规、车规等领域。具体来说，IoT类客户占比50%~60%左右，PA类占比15%左右，安防领域占比15%，运算领域和汽车电子领域的营收绝对占比较低，但增速较快。从公司的观察看，下游IoT客户需求较为乐观；PA领域二季度相对平淡，预计下半年会有所回暖。  **4.公司下半年的营收情况和费用情况？**  公司预计下半年营收仍将保持环比增长的态势；费用端，随着公司产能持续爬坡、营收规模持续扩大，除研发费用率保持较高强度外，其他费用率会随规模效应的体现呈现降低趋势。  **5.目前对行业景气度的预期？**  今年集成电路产业整体呈现复苏趋势。从下游客户来看，公司主要客户以各细分领域的龙头设计公司为主，在所处领域具备较强的竞争力，客户的成长会进一步带动公司的持续增长。  **6.Q3的毛利率大概会到什么水平？**  从财务角度看，影响毛利率的核心因素有两个，一个是稼动率，另一个是价格，公司稼动率处于较高水平，从目前来看，价格处于相对稳定的状态。随着公司营收规模进一步扩大，以及一些新产品的导入和产品结构的变化，对毛利率会形成正向的影响。  **7.公司的稳态毛利目标？**  公司专注中高端封测，相信随着公司营收规模的扩大，规模效应逐渐体现，会摊掉更多的成本，对毛利会有正向的提升作用。  **8.公司目前细分领域的毛利情况？**  公司2024年上半年的综合毛利率为18.01%，其中SiP和FC产品的毛利率较高，分别达到24.65%和21.13%。  **9.公司先进封装的能力和人才储备？**  公司Bumping和WLP去年已经通线并量产，Fan-out在和客户做量产前的验证。2.5D项目的设备已全部move-in，正在调试，预计今年四季度通线。公司坚定看好先进封装领域，并做了大量人才储备。  **10.公司目前的设备国产化进度？**  公司根据自身的工艺需求和客户的需求审慎进行设备选型，综合考虑量产的稳定性以及客户的接受度等角度，目前核心站别以进口设备为主。同时公司高度重视国产替代，主要站别均有相对应的国产设备的备选方案，并且有相对应的配置跟demo，配套公司在国产设备上的工艺开发。  **11.台湾大客户选择公司的原因？**  台湾客户基于多种考虑在寻求供应链本土化，公司在发展的过程中与台湾地区的头部客户也存在业务合作。从商务角度来说，在技术水平相当的情况下，公司在成本、交期、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。  **12.公司的客户会不会考虑自己做封测？**  芯片设计公司分为Fabless和IDM两种模式，公司客户一般是Fabless，即无制造环节。  **13.公司的市场定位及打法？**  公司坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，一方面，公司推进成熟产线的扩产，另一方面，积极布局先进封装和汽车电子领域，按市场需求稳步推进包括 Bumping、晶圆级封装、FC-BGA、汽车电子的QFP等新产品线布局。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年9月11日 |